親愛的企業成員 您好：

　　感謝貴公司加入半導體產業人才創能加值計畫(TDPSI)平台會員，請您依據所參與之人才加值模式辦理情形填寫下列問卷，您的寶貴意見將成為我們日後規劃與辦理相關模式的重要參考，感謝您的合作！

半導體產業人才創能加值計畫 敬啟

填寫日期：

主題名稱：

1. **請問您所參與的多元加值模式的滿意度？**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項目** | **非常滿意** | **滿意** | **普通** | **不滿意** | **非常不滿意** | **原因與建議** |
| 1. **產學研專家師資**
 | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | **您是否有想特別推薦專家/顧問：(請寫名字)** |
| 1. **本案實用程度**
 | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |  |
| 1. **本案時數安排**
 | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |  |
| 1. **對於專業技能有所提升**
 | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |  |
| 1. **加強觀念或增廣專業知識**
 | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |  |
| 1. **解決現在工作實務問題的幫助程度**
 | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |  |
| 1. **提升未來工作能力之實質幫助**
 | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |  |
| 1. **整體滿意度**

(1-5分，5分=非常滿意) |  分，原因： |

1. **請問以下哪種人才加值模式會吸引您參與？(可複選)**

|  |  |
| --- | --- |
| ⬜**顧問導入/場域實作**：聚焦廠區、產線實務技術主題之實作應用演練及顧問諮詢 | ⬜**企業講座**：引薦國內外專家師資講授技術個案或科管主題討論交流 |
| ⬜**產業鏈共創**：針對通用性新興技術需求，以產業上下游供應鏈合作夥伴為對象辦理共同研習 | ⬜**其他**：請填寫 |

1. **是否願意持續參與產業發展署半導體產業人才創能加值計畫(TDPSI)辦理之人才加值模式？**

⬜是

⬜否，原因或建議

1. **日後是否願意持續收到產業發展署半導體產業人才創能加值計畫(TDPSI)相關訊息?**

⬜是，姓名： Email:

⬜否，原因或建議

1. **其他建議：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**經濟部產業發展署**

**蒐集個人資料告知事項暨個人資料同意書**

版本：P-V5x-RISD

**經濟部產業發展署（以下簡稱本署）**為遵守個人資料保護法令及本署個人資料保護政策、規章，於向您蒐集個人資料前，依法向您告知下列事項，敬請詳閱。

1. 蒐集目的及類別

本署因辦理或執行**半導體產業人才創能加值計畫**業務、活動、計畫、提供服務及供本署用於內部行政管理、陳報主管機關或其他合於本署所定業務、寄送本署或產業相關活動訊息之蒐集目的，而需獲取您下列個人資料類別：姓名、電子郵件。

※您日後如不願再收到本署所寄送之行銷訊息，可於收到前述訊息時，直接點選訊息內拒絕接受之連結。

1. 個人資料利用之期間、地區、對象及方式

 除涉及國際業務或活動外，您的個人資料僅供本署於中華民國領域、在前述蒐集目的之必要範圍內，以合理方式利用至蒐集目的消失為止。

1. 當事人權利

您可依前述業務、活動所定規則或以電子郵件聯繫(iei@iii.org.tw)向本署行使下列權利：

1. 查詢或請求閱覽。
2. 請求製給複製本。
3. 請求補充或更正。
4. 請求停止蒐集、處理及利用
5. 請求刪除您的個人資料。
6. 不提供個人資料之權益影響

若您未提供正確或不提供個人資料，本署將無法為您提供蒐集目的之相關服務。

1. 您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本署留存此同意書，供日後取出查驗。

**個人資料之同意提供：**

一、本人已充分獲知且已瞭解上述經濟部產業發展署告知事項。

1. 本人同意經濟部產業發展署於所列蒐集目的之必要範圍內，蒐集、處理及利用本人之個人資料。

立同意書人：(請簽名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

中華民國 年 月 日